V1.02修改内容

1. 去掉RS485及其外围电路；

2. R32/D3调整摆放位置；

3. TFT排线连接器镜像后移至PCB左侧；

4. RFIN到天线之间增加一颗并联Ln，构成PI型匹配网络；

5. 天线区域增加净空；

6. 铺铜区域接地过孔尺寸统一修改为10/20mil；

7. 增加铺铜区域接地过孔的数量；

8. 调整TFT排线接口到MCU的走线；

9. BUZ1逆时针方向旋转90DEG；

10. 修改铺铜最小走线线宽为10mil；

v1.04修改内容

1. 增加天线净空区域面积；

2. 将天线形式修改为PCB天线；

v1.04M1修改内容

1. 调整产品名称，版本号，修改日期的丝印；

2. 修改L1(6.8nH)为L1(NULL);

3. 修改C27(2.7pF)为C27(1.8pF);

4. 修改Ln(6.8nH)为C6(0.8pF);

v1.05M1修改内容

1. 修改电源及CAN接口封装；